



半导体行业专用压力表 GW系列

概述

该产品可测量高纯度的半导体气体，可用于存在腐蚀性的空气等恶劣的场合，由于制作时充分考虑到该产品的气密性和清洁度，因此非常适合应用于半导体生产线和测量高纯净流体。

特征

- 波登管、底座、外壳以及内部机芯都是由不锈钢制成，具有极好的耐腐蚀性。
- 接液部利用氩弧焊接法焊接，耐压以及气密性极好。
- 外壳配备溢流孔，一旦波登管发生破裂，内部压力可以通过其向外界释放，防止玻璃面板的毁坏。


※请将压力的范围置于满刻度的30%~65%之间，这时压力表的测量最准确。也请确定压力表接液部的材质是否适合被测流体。

规格

测量介质:

气体或液体

安装方式:

径向  A型

轴向  D型 (安装夹具)

表盘尺寸:

φ50 (型号: GW11/16/21)

φ60 (型号: GW12/17/22/27)

连接口径:

1/4 (PT), 9/16-18UNF, 1/4NPT, G1/4B (PF)

接液部材质:

波登管·底座 SUS316 (GW2□为SUS316L)

外壳 SUS304

内部机芯 SUS

接气部内部:

GW2□ 特殊镜面抛光处理

焊接方式:

氩弧焊接

压力范围:

0~0.2→0~100MPa

-0.1~0.1→0.1~2MPa

(A级只能做0~25MPa以下, 0~35MPa以上直径只能选φ60)

使用温度范围:

-5~40°C

精度:

±1.5%F.S.

气密性 (He真空法):

$1.01 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

禁油、禁水处理:

除去残留在接液部的水或油。

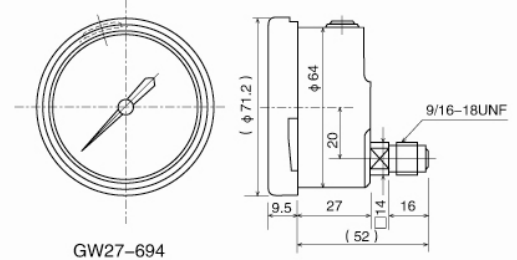
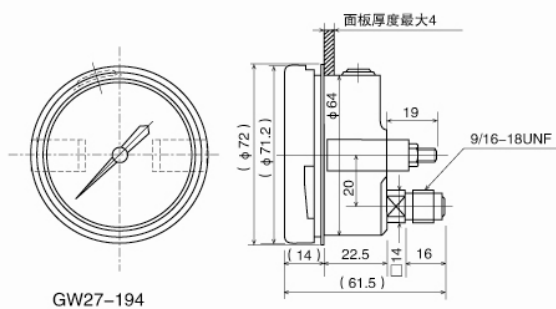
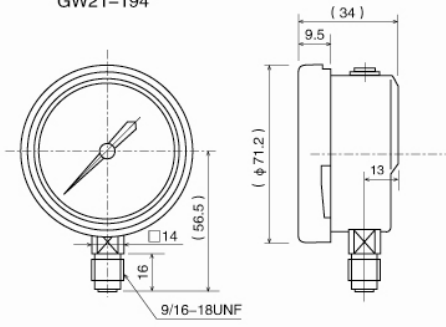
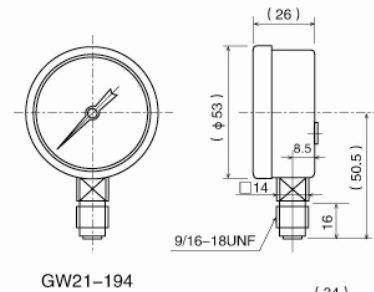
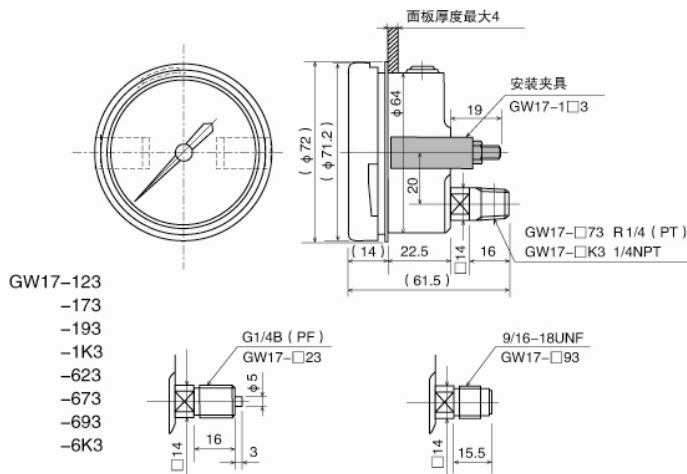
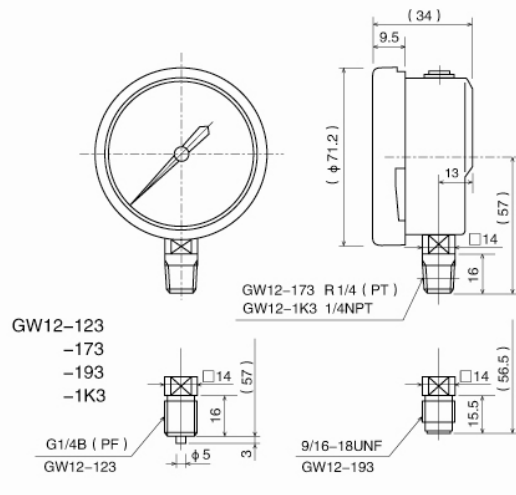
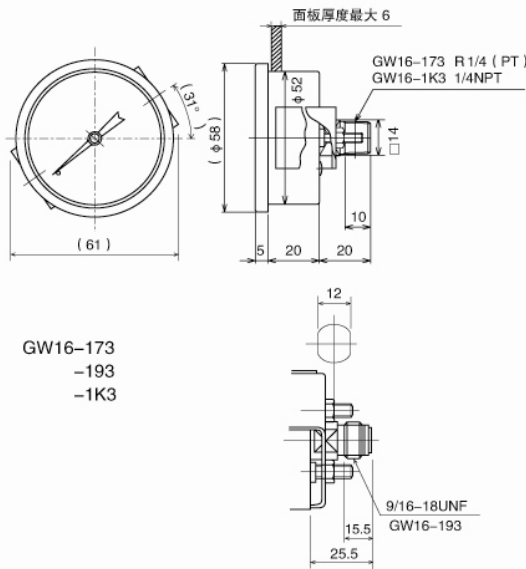
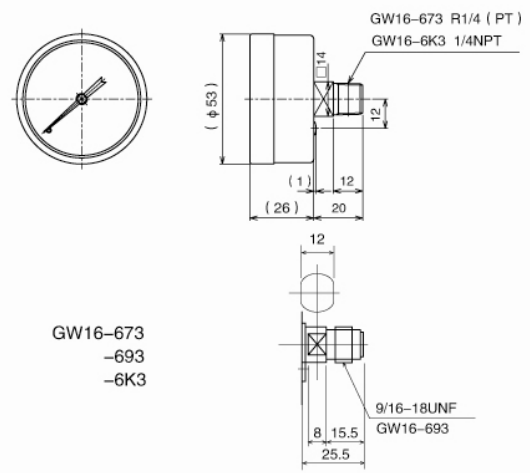
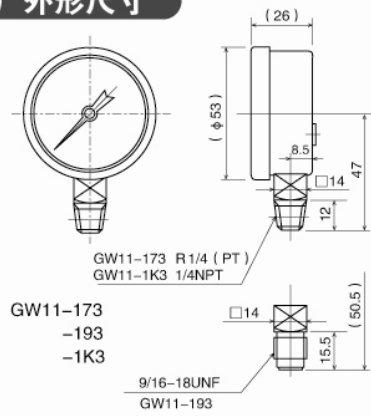
重量:

约350g

※注意事项:

为了保证溢流孔的正常性能，请在表后面留出至少10mm的空间，不要改装或塞住溢流孔。

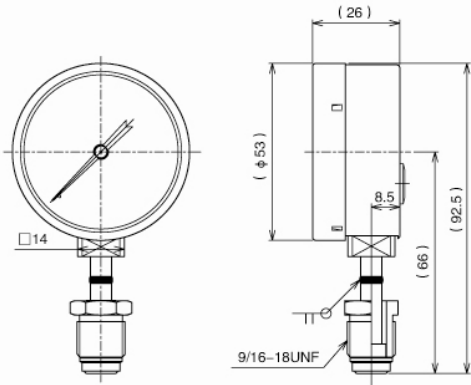
外形尺寸



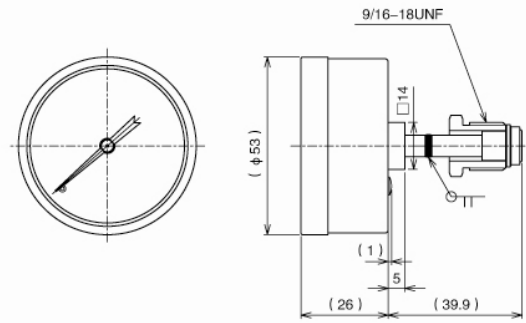
半导体行业专用压力表GW系列

外形尺寸

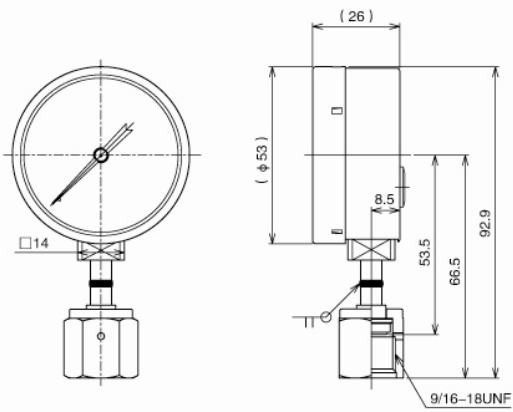
GW21-1E4



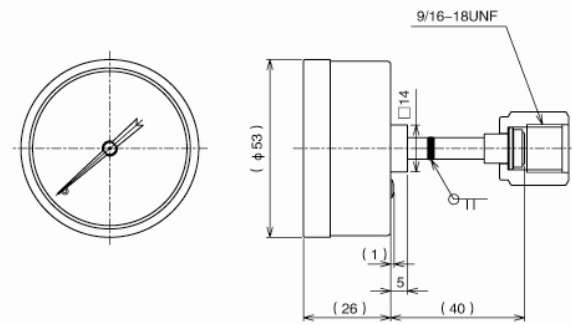
GW26-6E4



GW21-1G4



GW26-6G4



级别构成表

压力表的级别构成是按清洁以及生产、检测过程的内容半划分。标准如下表所示。

规则	A	B
清洁度	见右表	
清洗	超声波清洗	禁油+禁水清洗处理
构造·调整	在无尘室内(等级10,000)	一般生产线
气密性检查	He真空法	He真空法
禁油·禁水	禁油+禁水清洗处理	禁油+禁水清洗处理
包装	充N ₂ (氮气)后, 使用聚乙烯密封包装	聚乙烯袋

清洁度表

级别	微粒子及纤维数量										碳氢化合物的允许数量 (最大值: ppm)	
	微粒子的尺寸(μm)					纤维的尺寸(μm)						
	0~20	20~50	50~100	100~500	500~1000	0~20	20~50	50~100	100~700	700~1000		1000~6000
A	(a)	(a)	(a)	5	1(b)	(a)	(a)	5	1(b)	-	-	-
B	(a)	(a)	(a)	25(b)	-	(a)	(a)	(a)	(a)	(b)	-	50

注: (a) 无限制
(b) 此为最大尺寸

* 接液部内部: 特殊镜面抛光处理A级

选型规格

选型时请指定型号、规格、压力范围

型号

GW1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

半导体行业专用压力表
A·B级

基本型号		基本选型		可选项	
类型	外形	外壳材质/安装	接液部	连接螺纹	
	1	φ50径向 SUS304 就地	SUS316	R1/4	
	6	φ50轴向 SUS304 就地	SUS316	R1/4	
	2	φ60径向 SUS304 就地	SUS316L	G1/4B	
	7	φ60轴向 SUS304 就地	SUS316L	G1/4B	
① 形状	1	径向	轴向		
	6	A型	D型(安装夹具)		
② 连接螺纹	2	G1/4B	GW11·16不能制作		
	7	R1/4			
	9	9/16-18UNF			
	K	1/4NPT			
		其他指定			
③ 接液部材质	3	SUS316			
(当订货时, 请标明压力范围及单位)	④ 压力范围(MPa)	1	-0.1~0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2		
		2	0~0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5		
		3	0~5, 7, 10		
		4	0~15, 25		
		5	0~35	GW12·17只能做B级	
		6	0~50, 70	GW12·17只能做B级	
		7	0~100	GW12·17只能做B级	
⑤ 性能	0	标准(±1.5%F.S.)			
⑥ 指针	0	标准形			
⑦ 玻璃	0	标准(无机玻璃)			
⑭ 级别	0	B级			
	W	A级			
⑮ 资料	0	无			
	1	其他(请单独标明需求的文件) 图纸、使用说明书、检查要领书、制造工艺流程表、检测报告(每个产品1份)检查/可追溯证明			

半导体行业专用压力表GW系列

选型规格

选型时请指定型号、规格、压力范围

型号

G	W	2	—	9	4	—	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	
半导体行业专用压力表 A级				①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮

基本型号		基本选型		可选项	
类型		外形	外壳材质/安装	接液部	连接螺纹
	1	φ 50径向	SUS304 就地	SUS316L	9/16-18UNF
	2	φ 60径向	SUS304 就地	SUS316	9/16-18UNF
	7	φ 60轴向	SUS304 就地	SUS316L	9/16-18UNF
① 形状		径向	轴向		
	1	A型	D型 (安装夹具)		
② 连接螺纹	9	9/16-18UNF			
		其他指定			
③ 接液部材质	3	SUS316			
④ 压力范围 (MPa)	1	-0.1 ~ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2			
	2	0 ~ 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5			
	3	0 ~ 5, 7, 10			
	4	0 ~ 15, 25			
⑤ 性能	0	标准 (± 1.5% F.S.)			
⑥ 指针	0	标准形			
⑦ 玻璃	0	标准 (无机玻璃)			
⑭ 级别	W	A级 (接液部内部: 特殊镜面抛光处理)			
⑮ 资料	0	无			
	1	其他 (请单独标明需求的文件) 图纸、使用说明书、检查要领书、制造工艺流程表、检测报告 (每个产品1份) 检查/可追溯证明			

(当订货时, 请标明压力范围及单位)